



Technische Eigenschaften (Gehäuse / System)

- ◆ Robustes und kompaktes Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, pulverbeschichtet
- ◆ Abmessungen (HxBxT): 235 x 103 x 222mm
- ◆ Gewicht ohne Zubehör: ca. 4kg
- ◆ Spannungsversorgung: 24 VDC, Phoenix COMBICON Raster 5,08 2-pol. redundant
- ◆ Betriebstemperatur: 0°C – 45°C

Der BEG-Standard

- ◆ Systemauslegung: 24/7 Betrieb
- ◆ 24h Burn-In Test: Reduzierung von Frühausfällen auf ein Minimum
- ◆ Digitaler Zugang zu Prüfprotokoll und Qualitätspass pro Seriennummer
- ◆ Traceability: Rückverfolgbarkeit der wichtigsten Systemkomponenten
- ◆ 24 Monate Gewährleistung
- ◆ CE Konformität
- ◆ EOL-Management
- ◆ ISO 9001:2015

Vorteile

- ◆ Wartungsfreies lüfterloses System
- ◆ Staubgeschützt durch geschlossenes Gehäuse
- ◆ Produktlanglebigkeit
- ◆ Umfassende I/O Möglichkeiten durch RiserCard
- ◆ Ausgezeichnete Wärmeableitung
- ◆ Verpolungsschutz für Spannungsversorgung

Ausstattung

- ◆ Industrielles Mainboard basierend auf Q170 Chipsatz (Intel Skylake)
- ◆ Prozessor: 6th Generation Intel Core i5-6500TE, Quad-Core, 2,3GHz
- ◆ Grafik: Intel HD Graphics 530
- ◆ Hauptspeicher: 8GB RAM DDR4
- ◆ Massenspeicher: SSD mSATA 240GB MLC

Externe Schnittstellen:

- ◆ 2 x LAN RJ45 (10 / 100 / 1000Mbit)
- ◆ 4 x USB 3.0
- ◆ 1 x DVI-I (DVI-D signal)
- ◆ 1 x HDMI
- ◆ 2 x COM RS232/422/485 DSUB9M (via Jumper)

Frei verfügbare Erweiterungssteckplätze:

- ◆ 1 x PCIe x16 (8 Lanes)



Systemkühlung

- ◆ Passive Kühlung

Unterstützte Betriebssysteme

- ◆ Windows 10 IoT

Bedien- und Anzeigeelemente

- ◆ Power-Taster
- ◆ Reset-Taster
- ◆ Power-LED
- ◆ SSD activity-LED

Montagemöglichkeiten

- ◆ Buchmontage
- ◆ Wall mounting

Zubehör

- ◆ Montagewinkel

Weitere Konfigurationen auf Anfrage

- ◆ Prozessor (Embedded Roadmap)
- ◆ Speicher
- ◆ Erweiterungskarten

